

手机材料

为手机内应用打造的
全线高品质、性能卓越的焊料产品



INDIUM
CORPORATION®
钢泰公司



微型化趋势的挑战

屏幕和触摸传感器

- 制造ITO的铟和锡氧化物
- 制造氧化物薄膜晶体管TFT的铟和镓氧化物
- 制造量子点的醋酸铟

系统级封装 (SiP)

- Indium3.2HF 焊锡膏
 - 细间距印刷：T6SG
 - 钢网寿命长、塌落极少

MEMS 麦克风

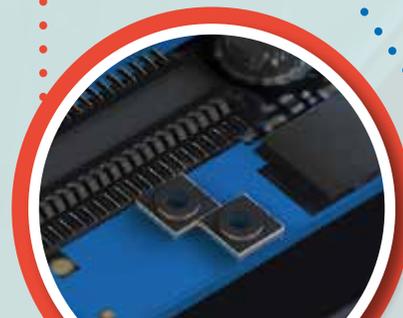
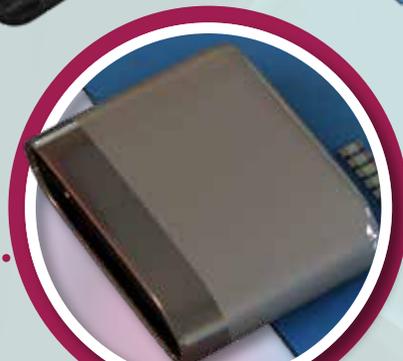
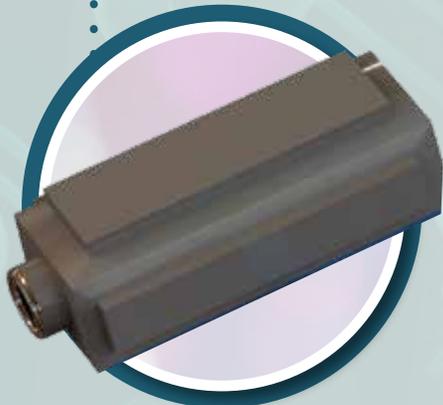
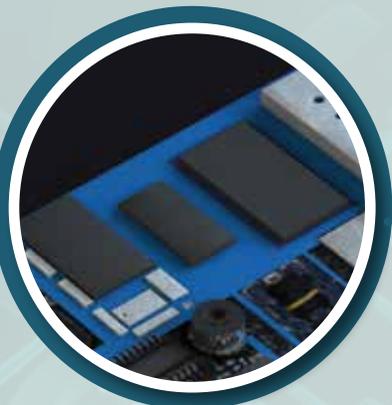
- NC-SMQ®77 盖封焊锡膏
 - 残留低
- Indium12.8HF 盖封焊锡膏
 - 滴涂一致
 - 减少气孔和焊点蠕变

连接器

- Solder Fortification® 焊片
 - 增加焊料量从而提高机械可靠性

GaAs 射频芯片

- 三氯化镓



PCBA 材料

照相机模块

- Indium8.9HF 焊锡膏
 - 助焊剂残留极少
 - 卓越的转印效率
- Indium5.7LT-1 焊锡膏
 - 低温
 - 残留物透明
- CW-807 含芯焊锡线
 - 喷溅少

主板 (MLB)

- Indium11.8HF-SPR 焊锡膏
 - 细间距印刷：T5MC
 - 消除热/冷塌落，防止桥连和锡珠产生
 - 低空洞
- Indium8.9HFA 焊锡膏
 - 快速印刷
 - 细间距印刷：T5MC

低温屏蔽罩焊接

- Indium5.7LT-1 焊锡膏
 - Indalloy®282—BiSnAg
- Solder Fortification® 焊片
 - 增加焊料量从而提高机械可靠性

柔性印制电路板 (FPC)

- Indium8.9HF 焊锡膏
 - 助焊剂残留极少
 - 卓越的转印效率
- CW-807 含芯焊锡线
 - 喷溅少

充电器/线使用的材料

- Indium8.9HF 焊锡膏
- WF-7745 (无可挥发性化合物) 波峰焊助焊剂
 - 卓越的填孔能力
 - 没有焊接后的绿色腐蚀
 - 减少锡珠缺陷
- WF-9945 波峰焊助焊剂
 - 高温下稳定
 - 卓越的填孔能力
 - 卓越的润湿能力



钢泰公司 服务全球

您的成功

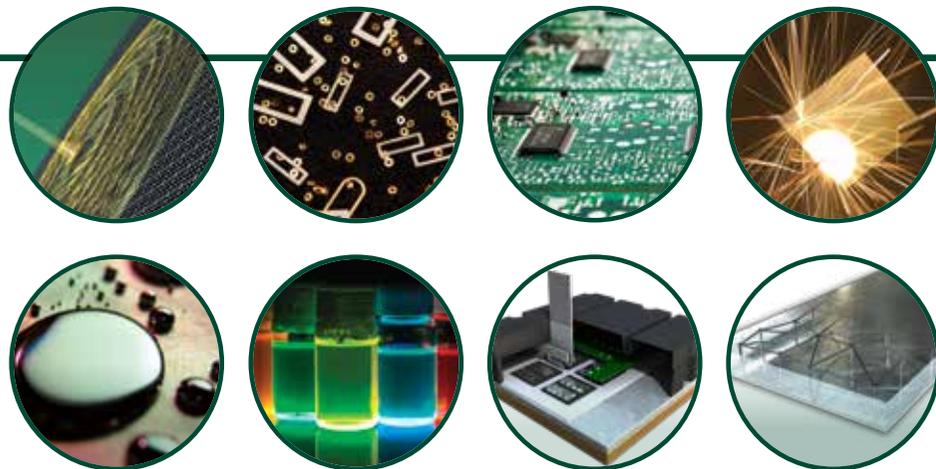
通过优化设计和应用以及提供先进材料，来提高我们客户的产能和利润。

钢泰公司 品质方针

- 提供满足甚至超越客户需求的高品质产品
- 创造专注于满足客户需求和持续提升自我的公司文化
- 生产符合法律法规的产品
- 致力于预防缺陷
- 及时处理内部及外部客户的意见
- 努力确认并提供必要资源

材料供应商

- SMT和SiP焊锡膏和助焊剂
- 功率半导体芯片粘接材料
- 半导体助焊剂
- 导热界面材料
- 无机化合物
- NanoFoil®



全球范围提供技术支持，生产/销售基地遍布世界

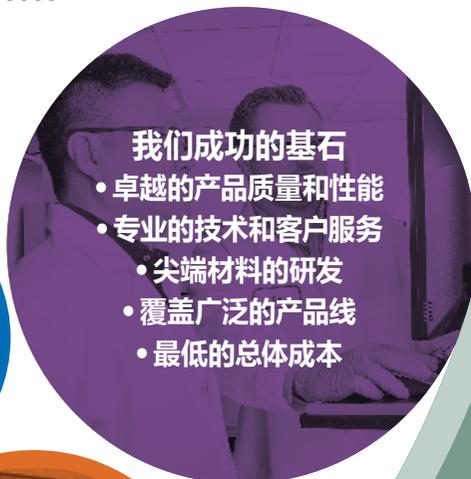


www.indiumchina.cn



钢泰公司 From One Engineer To Another®

世界一流的技術和管理： 从设计到生产



我们成功的基石

- 卓越的产品质量和性能
- 专业的技术和客户服务
- 尖端材料的研发
- 覆盖广泛的产品线
- 最低的总体成本



表格编号: 99565 (SC A4) R0
©2018 钢泰公司

